

نمذجة خلايا الخزن النانو بلورية

أزهار داود محمد سليم

سامي محمد طاهر عبد الموجود

لقمان سفر علي

جامعة الموصل / كلية الهندسة / قسم الهندسة الكهربائية

الخلاصة

تم عمل برنامج يوضح التحليلات الإحصائية للمتغيرات العشوائية بتطبيق طريقة (Monte Carlo) الإحصائية لمحاكاة نموذج نبيطة ذاكرة نانوبلورية ذات إلكترون-أحادي (5×5) نقاط كم لدراسة العلاقة بين الأبعاد الهندسية للنبيطة والخواص الكهربائية ، وتأثيرات الشحن - الأحادي في خواص البرمجة الاستاتيكية التي تتضمن العلاقات المداخلة بين النقاط، وكذلك تمت دراسة المتغيرات التي ينبغي تحديدها خلال تنفيذ البرنامج وعرض وتحليل النتائج التي تم الحصول عليها عند تنفيذ عملية المحاكاة لدراسة الخواص الكهربائية لعملية البرمجة.

Modeling of Nanocrystal Storage Cells

L. S. Ali

S. M. T. Abdul Mawjoud

A. D. Mohammed Saleem

University of Mosul - College of Engineering- Electrical Engineering Department

Abstract

The computer program is prepared for applying Montecarlo simulation and modeling for single-electron nanocrystal memories. The nanocrystal memory device of (5×5) quantum dots is used for studying the relationship between, geometrical dimensions, electrical characteristics and charging effects for single electron static programming characteristics. The nanocrystal inter-dot effects are included. All parameters got in the memory simulation programming are studied and discussed.

Keywords: Nanocrystal Memories.

1- المقدمة :

إن الدراسة المتعلقة بأشباه الموصلات في خزن البيانات والتفسير الفيزيائي لكيفية الخزن هي أساس بناء الذاكرات المايكروية من أشباه الموصلات. إن الخزن يتم عن طريق الاحتفاظ بالاكترونات داخل مادة موصولة موجودة في وسط عازل (بوابة عائمة).

قامت مجموعة من الباحثين الكوريين [1] (Yu et al., 2001) باقتراح نموذج خلية ذاكرة الكترون - أحادي جديدة. وقد أظهرت نتائج التمثيل طريقة عمل مقبولة لخلية الذاكرة.

نفذت مجموعة من الباحثين الكوريين [2] (Sung et al., 2002) طريقة نمذجة جديدة لذاكرة الكترون - أحادي نوع (MOS) ذات نقطة كم محددة. وأظهرت النتائج أن نباتات الذاكرة المصنعة تعطي سمات جيدة بخصوص شحن الالكترون والتأرجح بفولتية العتبة وكذلك تبين مقدار الزحف بفولتية العتبة دالة لاحتياز البوابة عند درجة حرارة الغرفة. وفي العام نفسه قامت مجموعة من الباحثين [3] (Brault et al., 2002) بدراسة لتصغير حجم (MOSFETs)، حيث اهتم العاملون في هذا البحث بتحقيق نباتات ذاكرات (MOSFET) ذات نقاط كم خزنية سلكونية صغيرة أقل من nm (10) التي تقع بين البوابة والقناة للـ (MOSFET)، والتي تقوم بخزن الالكترونات، حيث تتم السيطرة بدقة على عدد الالكترونات في النقطة بتأثير حجز الشحنة (Coulomb Blocked) (CB).

وفي عام 2004 قامت مجموعة من الباحثين [4,5] بتقديم نموذج ذاكرة نانوبلورية للفاطع العائمة التي تستغل ميكانيك الكم. وأظهرت النتائج أن الزيادة في زحف فولتية الحزم المستوية تعود إلى الالكترونات المخزونة في النقاط النانوبلورية. وكذلك فإن عمليات الشحن والتغريب عبر نقاط خزنية متتالية تؤدي إلى تولد زمن استبقاء طويل وبالتالي تقل السرعة.

والهدف من البحث هو تصميم نموذج خلية خزنية لذاكرة النانوبلورية من نقاط الكم الصغيرة ذات العدد = (5×5) ومحاكاته بطريقة مونتي كارلو الإحصائية في دوائر تنفيذ الالكترون الأحادي لغرض دراسة خواصه البرمجية.

2- الفرضيات والنتائج :

تم إجراء بعض الحسابات الرياضياتية والإحصائية لمعرفة أداء نموذج الذاكرة المبين في الشكل (1) والذي تمت محاكاته بطريقة (Monte Carlo) لدراسة تأثير الأبعاد الهندسية في خواص البرمجة الاستاتيكية للشحنة - الأحادي وفيما يأتي تفاصيل ذلك :

تم افتراض درجة الحرارة (T) تساوي (300°K) وإن زمن فتره البرمجة طويلة بما يكفي للوصول لحالة حجز الشحنة ولكن لا يسمح بتنفيذ إضافي. عند زيادة قيمة (T) فوق (0°k) فإن طاقة التذبذب الحراري (thermal fluctuation energy) تزداد بمقدار قليل عن طاقة الشحن الجزئية ($q^2/2C$) (Coulomb charging energy) حيث (K_B) ثابت بولتزمان ، (q) شحنة الالكترون ، و (C) المتسعة الكلية ل نقاط الكم. وهذا يؤدي إلى توسيع تأثير الشحن- الأحادي في الخواص الكهربائية ، ووفقاً لما ورد في بحوث سابقة [5,4] فإن طاقة الشحن لنقطة كم بقطر nm (~5) لا تزال أكبر من الطاقة الحرارية حتى عند درجة حرارة الغرفة. لقد تم اختيار الأبعاد الهندسية وحجم النقطة بعناية وفقاً للعديد من التقارير حصول صناعة هذه النباتات فعلى سبيل المثال في حالة ($T_{gap} = 4 \text{ nm}$ و $T_{qd} = 4 \text{ nm}$ و $T_{ctrl} = 20 \text{ nm}$ و $L/W = 20 \text{ nm} / 20 \text{ nm}$) تكون كثافة الشحنة السطحية للنقطة (dot density) في الذاكرة النانوبلورية حوالي ($1.6 \times 10^{12} \text{ cm}^{-2}$) وحجم النقطة.

ولغرض تنفيذ البرنامج يجب مراعاة قيم المتغيرات والقواعد الآتية :

أولاً - عند البدء بتنفيذ البرنامج اعطاء قيم للمتساعات (C_{gap} و C_{ctrl} و C_{ox} و C_{frg}) والأبعاد الهندسية (T_{ox} ، T_{ctrl} ، T_{qd} ، T_{gap}) والموضحة في الشكل (1) والمذكورة قيمها في الجدول (1).

ثانياً - تم إيجاد القيم الابتدائية لحالة الشحنة لنقطة الكم (F_0 , Q_{g0} , V_{g0}) من القوانين الآتية [4]:

$$V_{g0} = q / (C_{ctrl} + C_{ox}) = 0.25 \text{ Volt} \quad \dots(1)$$

$$Q_{g0} = \left(\sum_{i=1}^{25} C_{ctrl-i} + C_{frg} \right) V_{g0} = 2.5825 \times 10^{-19} \text{ Coulomb} \quad (i = 1, 2, \dots, 9) \quad \dots(2)$$

$$F_0 = -0.5 \times Q_{g0} \times V_{g0} = -3.228125 \times 10^{-20} \text{ Joule} \quad \dots(3)$$

حيث أن (V_{g0}) هي الفولتية اللازمة لانتقال أول إلكترون إلى نقطة الكم و (Q_{g0}) هي الشحنة الإبتدائية للبوابة الرئيسية و (F_0) تمثل الطاقة الكلية للنظام قبل التنفيذ.

ثالثاً - ولحالة انجاز جديدة :

- تم إيجاد قيم (V_{dot-i}) من المعادلة :

$$-q [n_i] = [C] [V_{dot-i}] \quad \dots (4)$$

ومن تعويض قيم المتساعات ($C_{ii} = C_{ox}$) و ($C_{ij} = C_{gap}$) وبأخذ معكوس مصفوفة المتساعات نجد قيم (V_{dot-i}) وكما يأنـي :

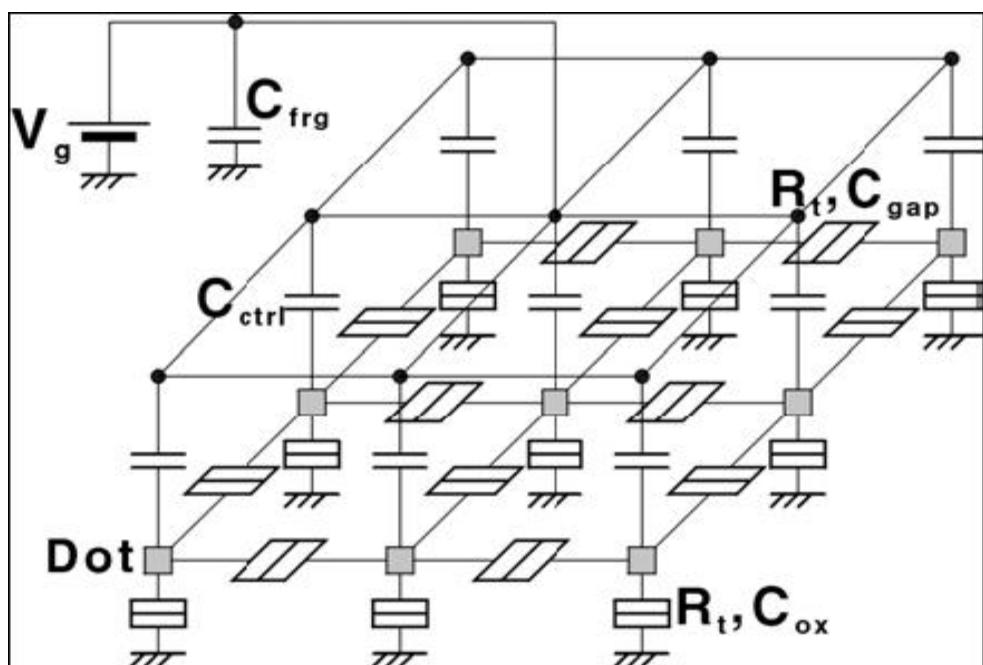
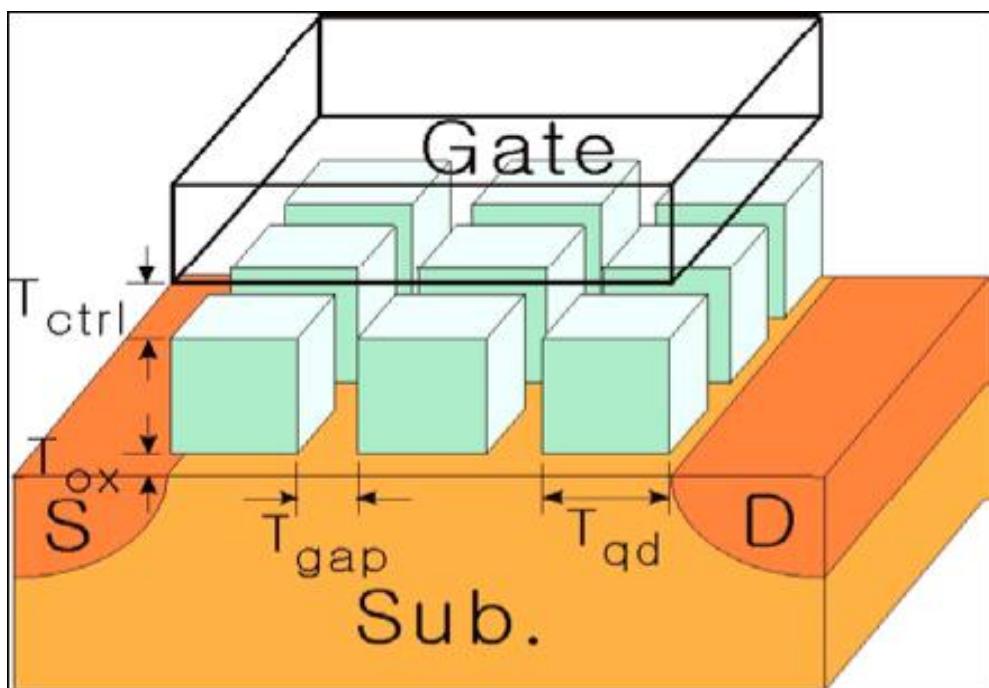
$$[V_{dot-i}]_{1 \times 25} = -q [C]^{-1}_{25 \times 25} [n_i]_{1 \times 25} \quad \dots (5)$$

حيث تم الأخذ بنظر الاعتبار التتفيق بين النقاط المجاورة كما في الشكل (1) عبر (C_{gap}) والتفيق من القناة لنقطة عبر (C_{ox}) ومن تعويض قيم (C_{gap}) و (C_{ox}) من الجدول (1) وبما ان انتقال الاكترونات يكون عشوائياً إلى النقاط ، فقد تم أخذ جميع الاحتمالات الممكنة في كون انتقال الإلكترون الأول إلى النقطة رقم (1 أو 2 أو 3 ... أو 25) من القناة أو من نقاط الكم المجاورة ، ويتم تحديد أي من هذه النقاط حسب قيمة (t_{min}) والذي سيتم ذكره لاحقاً ، وبعبارة أخرى (أما $(n_{25} = 1 \dots n_2 = 1 \dots n_1 = 1$.

الجدول (1) قيم المتساعات المستخرجة لابعاد معاملات هندسية مختلفة للذاكرات النانوبلورية [4].

	Split 1	Split 2	Split 3	Split 4	Split 5	Split 6
T_{ox} (nm)	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
T_{ctrl} (nm)	20	20	20	20	20	10
T_{qd} (nm)	4	4	4	3	5	4
T_{gap} (nm)	4	2	6	4	4	4
C_{ox} (aF)	0.655	0.528	0.744	0.415	0.952	0.655
C_{ctrl} (aF)	0.160	0.107	0.213	0.114	0.214	0.306
C_{gap} (aF)	0.282	0.516	0.163	0.179	0.370	0.261
C_{frg} (aF)	0.631	0.006	3.213	1.125	0.244	1.224
$C_{qd-to-ch1}$ ($\mu F cm^{-2}$)	2.04	1.96	2.06	1.83	2.17	2.04
$C_{qd-to-ch2}$ ($\mu F cm^{-2}$)	0.825	1.15	0.654	0.775	0.860	0.825
$C_{qd-to-ch3}$ ($\mu F cm^{-2}$)	0.407	0.728	0.281	0.398	0.411	0.405
$C_{gate-to-ch2}$ ($\mu F cm^{-2}$)	0.119	0.003	0.343	0.259	0.039	0.231
$C_{gate-to-ch3}$ ($\mu F cm^{-2}$)	0.200	0.006	0.533	0.390	0.073	0.387

حيث أن (j = عدد الاكترونات في المرحلة) و (k = موضع الإلكترون في النقطة) أي أن احتمالية انتقال أول إلكترون إلى أي من النقاط ($j=1, k=1,2,\dots,25$) وانتقال ثاني إلكترون ($j=2, k=1,2,\dots,25$) وقد تم إيجاد قيمة Q_{gk} بعد انتقال أول إلكترون وتساوي ($4.1825 \times 10^{-19} C$) لأية نقطة .



الشكل (1) : (a) رسم تخطيطي لهيكل الذاكرة النانوبلورية (b) دائرة مفارق التنفيذ الاحادي (STJs) المكافئة للذاكرة النانوبلورية خلال عملية البرمجة [4] .

- تم إيجاد قيم $(\sum V_{dot-i}, V_{dot-i})$ لجميع الاحتمالات (وعددتها خمسة وعشرون) ثم إيجاد قيمة فولتية البوابة من المعادلة :

$$V_{g-kj} = (Q_{kj} + \sum C_{ctrl-i} \times V_{dot-i}) / (\sum C_{ctrl} + C_{frg}) \quad \dots (7)$$

علمًا أن فولتية النقطة تتحفظ بمقدار $\left(\frac{nk \times q}{C_{ctrl} + C_{ox}} \right)$ في حالة انتقال الإلكترون إليها وبعوض هذا النقصان بالفولتية من الزيادة الإضافية لفولتية البوابة (V_{g-k}) إلى أن تصل (V_{th}) للإلكترون المنقول وقيمة (V_{dot-i}) كما في المعادلة التالية :

$$V_{dot-i} = \left(V_{dot-i} - \frac{n \times q}{C_{ctrl} + C_{ox}} \right) \quad \dots (8)$$

- ومن القيم السابقة تم إيجاد (F_k) لكل عمليات التتفيق الممكنة عند $(STJs)$ عند إنتقال أول الكترون مثلاً وحسب المعادلة [5] :

$$F_k = -0.5 q (\sum n_i \times V_{dot-i}) - 0.5 Q_{gk} V_{g-k} \quad (\text{Joule}) \quad \dots (9)$$

حيث F_k تمثل الطاقة الكلية للنظام بعد عملية التتفيق ، ونلاحظ بأن قيمة (F_k) قد ازدادت بعد انتقال أول الإلكترون عن القيمة الابتدائية قبل التتفيق ، لذلك قد يحدث إخماد للانتقال عند هذا المدى وهذا ما يسمى بجز الشحنة ، ثم تم إيجاد قيمة (ΔF) والتي تساوي الفرق بالطاقة للنظام قبل وبعد التتفيق فعند أول الإلكترون $k=0$ ، $k-1=1$ فإن :

$$\Delta F = F_k - F_{k-1} \quad (\text{Joule}) \quad \dots (10)$$

$$\Delta F = F_1 - F_0$$

وقد تم حساب قيمة (Q_{gk}) و V_{dot-i} و V_{g-k} و ΔF و F_k و V_{dot} سابقًا .

رابعاً - هناك نوعان من عمليات التتفيق عبر $(STJs)$ هما :

1- التتفيق عبر $(STJs)$ من القناة إلى نقاط الكم :

- حيث تم إيجاد قيمة المجال الكهربائي (E_{ox1}) المسلط على أوكسيد التتفيق في (تركيب MOS) من المعادلة :

$$E_{ox_{ch-d ik}} = (V_{dot-i} - V_{FB}) / T_{ox} \quad (\text{V/m}) \quad \dots (11)$$

مع العلم أن $-V_{FB}$ هي فولتية الحزمة المستوية ، وتم إيجادها بالطريقة الآتية :
من المعلوم أن الذاكرات النانوبلورية هي نبائط من نوع (MOS) ولغرض حساب فولتية الحزمة المستوية لمتسعة $-\infty$ (MOS) نفرض ما يأتي [34]:

(i) أن تركيب بدن النبيطة شبه الموصل من نوع (P-type) مطعم بتركيز $(Na=10^{15} \text{ cm}^{-3})$.

(ii) أن نقاط الكم النانوبلورية ذات تعليم عال $(n^+ = 10^{20} \text{ cm}^{-3})$.

(iii) كثافة الشحنة السطحية $(Q_{ss} = 1.6 \times 10^{12} \text{ cm}^{-2})$.

لقد تم إيجاد الفرق في دالة الشغل بين البوابة والبدن وقيمتهما $(\phi_{ms} = -1.03 \text{ Volt})$ وإيجاد متسعة الأوكسيد :

$$C_{ox} = \frac{\epsilon_{ox}}{T_{ox}} = 1.3806 \mu \text{ F/cm}^2$$

وكثافة شحنة سطح الأوكسيد المكافئة من :

$$Q'_{ss} = Q_{ss} \times q = 2.56 \times 10^{-7} \quad \text{Coulomb / cm}^2$$

ومن ثم إيجاد فولتية الحزمة المستوية من :

$$V_{FB} = \phi_{ms} - \frac{Q'_{ss}}{C_{ox}} = -1.21542626 \quad \text{Volts}$$

- وبعد إيجاد قيمة المجال الكهربائي $(E_{ox_{ch-d}})$ لقيم معينة من $(V_{ox} = V_{dot-i})$ ولجميع احتمالات انتقال الإلكترون إلى أي من النقاط الخمسة والعشرين (أي بتعبير آخر إيجاد قيمة (E_{ox1}) عند انتقال الإلكترون إلى نقطة رقم (1) أي $(n_1=1)$ وإيجاد (E_{ox2}) لقيم (V_{ox2}) عند انتقال الإلكترون لنقطة رقم (2) أي $(n_2=1)$ وهكذا ، أي أن هناك خمسة وعشرين احتمالاً لحدوث مثل هذا التتفيق لأي من نقاط الكم) . ومن ثم يتم تحديد نوعين من معادلات التيار لإيجاد كثافة تيار التتفيق وفقاً لقيمة فولتية النقطة مقارنة بالجهد الحاجز وكما يأتي [5] :

(a) معادلة تيار التتفيق المباشر

تم استخدام المعادلة التالية في حالة كون جهد النقطة أقل من الجهد الحاجز.

$$V_{ox} < \phi_b$$

$$J_{\text{tunnel,direct}} = A \frac{V_{ox}}{\phi_b} \left(\frac{2\phi_b}{V_{ox}} - 1 \right) E_{ox}^2 \times \exp \left(\frac{-B \left[1 - \left(1 - \frac{V_{ox}}{\phi_b} \right)^{1.5} \right]}{E_{ox}} \right) \quad \dots (12)$$

(Fowler – Nordheim F/N) معادلة فولر – نوردهام

تم استخدام المعادلة التالية في حالة كون جهد النقطة أكبر من الجهد الحاجز [5].

$$J_{\text{tunnel,F/N}} = A E_{ox}^2 \exp \left(\frac{-B}{E_{ox}} \right) \quad \dots (13)$$

حيث أن:

$$A = q^3 / (8\pi h(q\phi_b)) = 4.9559 \times 10^{-7} \quad A / cm^2$$

$$B = 8\pi(2m_{ox})^{1/2}(q\phi_b)^{3/2} / (3hq) = 241.3272 \quad MV / cm$$

ومنها تم إيجاد قيم كل من (R_t , ΔF , R_t , I_{FN} , I_{dt}) حسب المعادلات التالية:

$$I = J \times \text{area} \quad \text{area} = (T_{qd} \times T_{qd}) cm^2$$

$$R_t = V_{dot} / I$$

$$\Gamma = -\Delta F / q^2 R_t [1 - \exp(-\Delta F / K_B T)]$$

- حيث أن قيمة (J) عند درجة حرارة الغرفة ($T = 300^\circ K$) $= 4.14 \times 10^{-21}$.

- بعد حساب قيم نسب التتفيق (Γ) لكل عمليات التتفيق عبر (STJs) بين القناة والنقطة وكل احتمالات انتقال الإلكترون الأول إلى إحدى النقاط الخمسة والعشرين من معرفة قيم (ΔF) و(R_t). كذلك تم حساب فترة التتفيق (tunnel interval) لكل (STJs) والذي يتولد عشوائياً من قيم (Γ) بالاستناد على التوزيع الأسوي الذي تكون دالة كافية لاحتمالية له [6]:

$$F(t) = \Gamma \exp(-\Gamma t) \quad \dots (14)$$

ومن ثم تحسب فترة التتفيق (t_{tun}) باستخدام مولد الرقم العشوائي (r) بمدى $: [6] r \leq 1$

$$t_{tun} = \frac{-1}{\Gamma^\pm} \ln(r) \quad \dots (15)$$

حيث أن (\pm) في المعادلة (15) تبين اتجاه انتقال الإلكترون ، وبما أن التتفيق عشوائي واحتمالية الانتقال إلى إحدى النقاط متساوية للأخر وهي [7]:

$$P(r) = \frac{1}{9} = 0.1111$$

ونلاحظ القيم المحسوبة (t , Γ , R , I , J) .

2. احتمالية التتفيق بين نقاط الكم :

- تم إيجاد قيمة المجال الكهربائي (E_{ox}) عبر الأوكسيد بين النقطتين من المعادلة [6]:

$$E_{ox,d-d} = \Delta V_{dot} / T_{gap}$$

ومن المعلوم أن (ΔV_{dot}) هي الفرق بين جهد نقطتين متجاورتين وهناك نوعان من تيارات التتفيق :

(a) تيار التتفيق المباشر وتستخدم المعادلة (12) في حالة ($\phi_b < V_{ox}$).

(b) معادلة (F/N) للتفيق بين النقاط المتجاورة وتستخدم المعادلة (13) في حالة ($V_{ox} > \phi_b$) ومنها تم إيجاد (I_{dt}) و(R_t) و(I_{FN}) من القوانين الآتية :

$$I = J \times \text{area} \quad \text{area} = T_{qd} \times T_{qd}$$

$$R_t = \Delta V_{dot} / I$$

ومن قيمة (R_t) و(ΔF) تم إيجاد نسبة التتفيق (Γ) ومنها فترة التتفيق (t_{tun}) حسب المعادلات

$$\Gamma = -\Delta F / q^2 R_t [1 - \exp(-\Delta F / K_B T)] \quad \dots (16)$$

$$t_{\text{tun}} = -\frac{1}{\Gamma} \ln(r) \quad \dots (17)$$

وقد تم أيجاد جميع القيم المحسوبة ، وكان عدد احتمالات التنفيق (80 حالة) بين النقاط .
خامساً -

- بعد أن تم الحصول على مجموعة احتمالات لفترة التنفيق (t_{tun}) لانتقال أول الكترون من كافة الاحتمالات الممكنة للتنفيذ (من القاء إلى النقطة ومن نقطة لأخرى) وكافة النقاط (وعدد هذه الاحتمالات $= 105 = 25 + 80$) ولاختيار قيمة (t_{tun}) الأكثر احتمالية يكون ما يأتي :

1- حسب نظرية (orthodox) ولغرض حصول تنفيق يجب أن يتحقق الشرط التالي [6] :

$$R_t > R_Q = h^2/e \approx 25.8 \text{ k}\Omega \quad (\text{مقاومة الكم})$$

2- من شروط تأثيرات الحجز الكمي (CB) أن تكون ($R_t >> 25.8 \text{ k}\Omega$) لذلك تم اختيار قيمة (R_t) من القيم التي وجدت سابقاً بحيث تكون أكبر من ($25 \text{ k}\Omega$) لتحقق نظرية (orthodox) لكن ليس أكبر بكثير لكي لا تتحقق تأثيرات الحجز الكمي [6] . ولهذا تم إهمال جميع قيم (t) التي عندها ($R \leq 25 \text{ k}\Omega$) وتم أيجاد :

(1) أقل قيمة لفترة التنفيق ($t_{\text{tun min}}$) من الاحتمالات ... (49).

(2) قيمة (F_1) عند ($t_{\text{tun min}}$) والتي تسلوي (F_0) للمرحلة الثانية.

(3) موقع الإلكترون في أي من نقاط الكم .

(4) قيمة الانحراف المعياري ($S_{\text{td}} \cdot D_{\text{ev}}$) لعدد الإلكترونات في النقاط (n_i) من المعادلة [6] :

$$S_{\text{td}} = \left(\frac{1}{n-1} \sum (x_i - \bar{x})^2 \right)^{1/2} \quad \dots (18)$$

(5) ولإيجاد قيمة (V_{th}) للاكترون المنتقل وحسب المعادلة التالية :

$$V_{\text{th-k}} = m \left(\frac{n \times q}{25C_{\text{ctrl}} + C_{\text{frg}} \frac{C_{\text{ox}} + C_{\text{ctrl}}}{C_{\text{ox}}}} \right) \quad \dots (19)$$

حيث أن (n) عدد الإلكترونات المنتقلة و(m) عدد المراحل .

- بذلك تم تحديد أول نقطة لرسم المنحني التابع لقيم (split-2) في الجدول (1) .

• في الخطوات السابقة تم تحديد انتقال أول إلكترون إلى نقطة الكم ، ثم يتم تكرار هذه الخطوات خمسة وعشرين مرة لانتقال خمس وعشرون الكترون إلى نقاط الكم (والمماثل بالجزء المائل من المنحني الذي يوضح علاقة فولتيّة البرمجة بمعدل عدد الكترونات في نقاط الكم (Mean Number of Electrons) في الشكل (2)) للوصول إلى فولتيّة العتبة للنبيطة . وحيث أن انتقال الإلكترون الثاني والثالث ... والي الخامس والعشرون خلال الأوكسيد تنتج عنه شحنة الكتروستاتيكية عند قطب البوابة فتصبح شحنة البوابة :

$$Q_{g-k} = Q_{g0} + jq \quad \dots (20)$$

حيث أن انتقال الإلكترون الثاني يعني ($k = 1, 2, \dots, 25$, $j = 2$)

- وبعد انتقال الإلكترونات الخمسة والعشرين يتم الوصول إلى فولتيّة العتبة للنبيطة التي يتم إيجادها من المعادلة التالية [6] :

$$V_{\text{th}} = m \left(\frac{25 \times q}{25C_{\text{ctrl}} + C_{\text{frg}}} \right) \quad m = 1, 2, \dots \quad \dots (21)$$

- بعد الوصول إلى فولتيّة العتبة للنبيطة ، ولكي ينتقل أول إلكترون للمرحلة الثانية (أي الإلكترون رقم (26)) يحتاج شحنة ابتدائية (Q_{g0}) مضافه للشحنة (Q_{g-i}) وكما يأتي :

$$Q_{g-m} = mQ_{g0} + jq \quad \dots (22)$$

وبتكرار جميع الخطوات السابقة للمرحلة الأولى أي انتقال خمس وعشرون الكترون أخرى للوصول إلى فولتيّة العتبة (أي المرحلة المستوى الثانية من المنحني) وهي المرحلة الثانية لحزز الشحنة وبتكرار المراحل تزداد الشحنة الإلكتروستاتيكية على البوابة الرئيسية بنفس المقدار [5].

ومنها تحسب قيمة (V_g) وبتكرار هذه العمليات الى أن تصل فولتيّة (V_g) الى ($5V$) ينتهي تنفيذ البرنامج ، وبذلك يمكن رسم المنحنيات الخاصة بعلاقة فولتيّة البوابة بمعدل عدد الالكترونيات وفولتيّة العتبة والانحراف المعياري للقيم المأخوذة من (split-2) من الجدول (1) والموضحة بالشكل (2).

- سادساً

تم تغيير قيم الادخالات (التي هي قيم المتسعات والابعاد الهندسية وعدد الالكترونيات) من (6, ..., 1,2) split في الجدول(1) وتنفيذ البرنامج لرسم مجموعة من المنحنيات وكما يأتي: (1) قيم ($T_{gap}=6nm$, $4nm$, $2nm$) في حالة تثبيت البعدين الآخرين على ($T_{ctrl}=20nm$) و ($T_{qd}=4nm$) والمبيّنة في (2) قيم ($T_{qd}=5nm$, $4nm$, $3nm$) في حالة تثبيت البعدين الآخرين على ($T_{ctrl}=20nm$) و ($T_{gap}=4nm$) والمبيّنة في (3) قيم ($T_{ctrl}=20nm$, $10nm$) عند تثبيت البعدين الآخرين على ($T_{gap}=4nm$) و ($T_{qd}=4 nm$) والمبيّنة في (4) قيم ($T_{ctrl}=20nm$) وقد تم رسم مجموعة من المنحنيات تمثل علاقـة فولـيـة البرـمـجـة بكلـ من مـعـدـلـ عـدـدـ الـالـكـتـرـوـنـاتـ فيـ النقـاطـ وـفـوـلـيـةـ العـتـبـةـ وـالـانـهـرـافـ المـعـيـارـيـ لـعـدـدـ الـالـكـتـرـوـنـاتـ وـهـذـاـ مـيـبـيـنـ فـيـ الشـكـلـ (2)ـ .ـ وقدـ تمـ رـسـمـ مـجـمـوـعـةـ منـ الـمـنـحـنـيـاتـ تـمـثـلـ أـيـضـاـ عـلـاقـةـ فـوـلـيـةـ البرـمـجـةـ بـكـلـ منـ مـعـدـلـ عـدـدـ الـالـكـتـرـوـنـاتـ وـفـوـلـيـةـ العـتـبـةـ وـالـانـهـرـافـ المـعـيـارـيـ وـهـذـاـ مـيـبـيـنـ فـيـ الشـكـلـ (3)ـ .ـ .ـ وقدـ تمـ رـسـمـ مـجـمـوـعـةـ الـمـنـحـنـيـاتـ المـذـكـورـةـ سـابـقـاـ لـقـيـمـ الـجـدـيـدـةـ وـهـذـاـ مـوـضـحـ بـالـشـكـلـ (4)ـ .ـ .ـ

3 - تحليل النتائج :

ويشمل التحليل الخواص الآتية :

3-3 دراسة خواص البرمجة الستاتيكية :

تمت دراسة تأثير المعاملات الهندسية (T_{ctrl} , T_{qd} , T_{gap}) في خواص البرمجة الستاتيكية للشحن-الأحادي ومن خلال استخدام القوانين السابقة في عمل برنامج لبيان تأثير الأبعاد الهندسية عليها ، تظهر عدة منحنيات توضح العلاقة بين فولتيّة البرمجة وكل من معدل عدد الالكترونيات المنتقلة للنقط وفولتيّات العتبة وكذلك الانحراف المعياري لعدد الالكترونيات والتي تكون بشكل متدرج وعلى أساسها يمكن اختيار أفضل حالة لتصميم خلية خزنية.

فيما يأتي تحليل تأثيرات تغير أحد هذه المعاملات مع تثبيت قيمة المعاملات الأخرى وكما يأتي:

3-1-3 تأثير المسافات بين النقاط (T_{gap}) على خواص البرمجة :

يوضح الشكل (2) أن تغيير المسافات بين النقاط يؤثر بشكل كبير على خواص البرمجة ، حيث أن معدل عدد الالكترونيات في النقطة النانوبلورية كدالة لفولتيّة البرمجة لقيم متعددة من (T_{gap}) والمبيّنة في الشكل (2-a) يظهر نتائج مختلفة عن ما تم استنتاجه في البحوث السابقة من ان الصفة المشابهة-الخطوة المثالية ممكنة في خواص البرمجة للذاكرة النانوبلورية كما هي في ذاكرة نقطة الكم-الأحادية في حالة ضمان انتظام نقاط الكم من حيث الحجم والمسافات . لكن وفقاً للنتائج التي تم الحصول عليها في هذا البحث ، ان الصفة المشابهة للخطوة تتوهن عندما تقارب النقاط من بعضها على الرغم ان الحجم والمسافات بين النقاط منتظمة تماماً وذلك لأن البحوث السابقة أهملت أهمية التفاعل بين النقاط [7].

وحيث أن المسافات القريبة بين نقاط الكم تزيد من قيمة متعددة الترابط بين النقاط وبالتالي التنفيذ لذلك فإن طاقة النظام الكلية تتأثر بشدة بالعلاقات المداخلة بين النقاط .

يمثل الشكل (2-b) العلاقة بين الانحراف المعياري لعدد الالكترونيات في نقاط الكم كدالة لفولتيّة البرمجة حيث يوضح طريقة توزيع هذه الالكترونيات في نقاط الكم وفقاً للشكل (2-a) حيث توجد دائماً منطقة متدرجة بين الاجزاء المستوية من المنحني ، ويمثل الجزء المستوي حالة حجز الشحنة الكامل عند فولتيّة بوابة معينة ويكون عدد الالكترونيات متساوياً في نقاط الكم كلها وبذلك تكون حالة الشحنة منتظمة وطاقة النظام الكلية تكون اقل ما يمكن ، اما في المنطقة المتدرجة (الجزء المائل) التي تمثل الحالة الانتقالية (العايرة) فلعدد الالكترونيات توزيع خاص يشابه التوزيع الطبيعي في نقاط الكم يقل طاقة النظام . ويعتبر الشكل (2-b) كمقاييس لنسبة الخطأ في التوزيع العشوائي . ومن الملاحظ انها نسبة مقبولة حيث أن اعلى قيمة (0.5) عندما يكون ترتيب النقاط في مسافات كبيرة نسبياً بما يكفي لتقليل تأثير النقاط المتراكبة فان لكل نقطة خاصية مستقلة لذلك فان علاقة معدل عدد الالكترونيات في النقاط مع فولتيّة البرمجة تصف الشكل المتدرج ، وان ترتيب النقاط بمسافات مقاربة يؤدي الى توسيع المنطقة المتدرجة فتضيق صفة التدرج وبذلك تشابه الصفة المستمرة للذاكرة الوэмضية التقليدية وهذا ما ينافي الاعتقاد السائد من ان الكثافة العالية او المسافات المترابطة لنقاط الكم هي

الصفة الجيدة لتحسين اداء النبيطة وفي الحالات الواقعية يكون من الصعب عند تصنيع النبائط الحصول على صفات أو ميزات برمجة حادة تماماً حتى عند درجة حرارة (0K) . والسؤال المطروح هو، هل ان المسافات البعيدة دائماً جيدة لتجنب التفاعل بين نقاط الكم النانوبولورية ؟ فللملاحظة الاكثر دقة على تأثير المعاملات الفيزيائية على خواص البرمجة يجب دراسة علاقة فولتية العتبة للذاكرات النانوبولورية لفولتية البرمجة وكما موضح في الشكل(c-2) .

أما من جهة إمكانية تطبيق ذاكرة-الإلكترون الأحادي كخلايا متعددة المستويات فمن المستحسن أن تكون الصفة المتدرجة حادة أو الجزء المستوي من المنحنى عريضة .

من الشكل (c-2) يمكن ملاحظة أن الترتيب المتبع لنقاط الكم نتج عنه زحف صغير بفولتية العتبة لكل إلكترون (ΔV_{th}) والتي تعتبر من المساوىء في التطبيقات العملية. وذلك لأن الترتيب ذات المسافات المتعددة يقال تأثير النقاط على منطقة القناة .

ان الزيادة بفولتية البرمجة المطلوبة لإضافة الكترون واحد (ΔV_p) الى نقطة الكم (والتي لا تتأثر بشكل ملحوظ بالمسافات بين النقاط لأن سمك أوكسيد السيطرة والبوابة وحجم النقطة ثابت. من الشكل (2-a)) نلاحظ انه بزيادة المسافة بين النقاط يزداد عدد الإلكترونات المخزونة فيها عند فولتية برمجة (3V) وذلك لأنه بزيادة المسافة تقل متسرعة الترابط فيقل التفريغ المتبادل وتقل طاقة الشحن للألكترون فتقل (ΔV_p) ويزداد عدد الإلكترونات .

3-1-2 تأثير حجم النقطة (T_{qd}) على خواص البرمجة :

يوضح الشكل (3) تأثير حجم النقطة (T_{qd}) على خواص البرمجة حيث ان الزيادة في فولتية البرمجة المطلوبة لإضافة إلكترون واحد (ΔV_p) في نقطة الكم، تكون أكثر عندما تكون النقطة أصغر حجماً ، وذلك لأن المتسعات الصغيرة لنقاط الكم الصغيرة تؤدي الى زيادة طاقة الشحن حيث أن طاقة الشحن هي $W_c = \frac{q^2}{2C_{it}}$.

إن التغير في فولتية العتبة (ΔV_{th}) في كل حالة يظهر تغييراً بسيطاً ، وذلك لسببين رئيسيين: الأول - هو حتى وإن كانت المتسعات الصغيرة لنقاط الكم تؤدي الى زيادة طاقة الشحن و (ΔV_{th}) فإن المظهر الجانبي للنقطة الصغيرة تقل السيطرة عبر منطقة القناة، والثاني - أنه في حالة الحجم الأصغر للنقطة عند نفس المسافات بين النقاط تقل بشدة كثافة مساحة النقطة في منطقة القناة الكلية والتي تؤدي الى إضعاف تأثير الشحنة المخزونة على (ΔV_{th}) . وهذا العاملان هما ما يميز الذاكرات النانوبولورية مقارنة بالذاكرة الومضية ذات نقطة الكم الأحادية والتي تتعرض تأثير زيادة طاقة الشحن . الشكل (3) يبين علاقة حجم النقطة بعدد الإلكترونات المنتقلة للنقطة حيث انه في حالة نقاط الكم الصغيرة تزداد طاقة الشحن فتزداد الفولتية التي يحتاجها الألكترون في الانتقال لذلك يقل عدد الإلكترونات المنتقلة خلال فولتية برمجة معينة ويفل عدد مستويات الخزن .

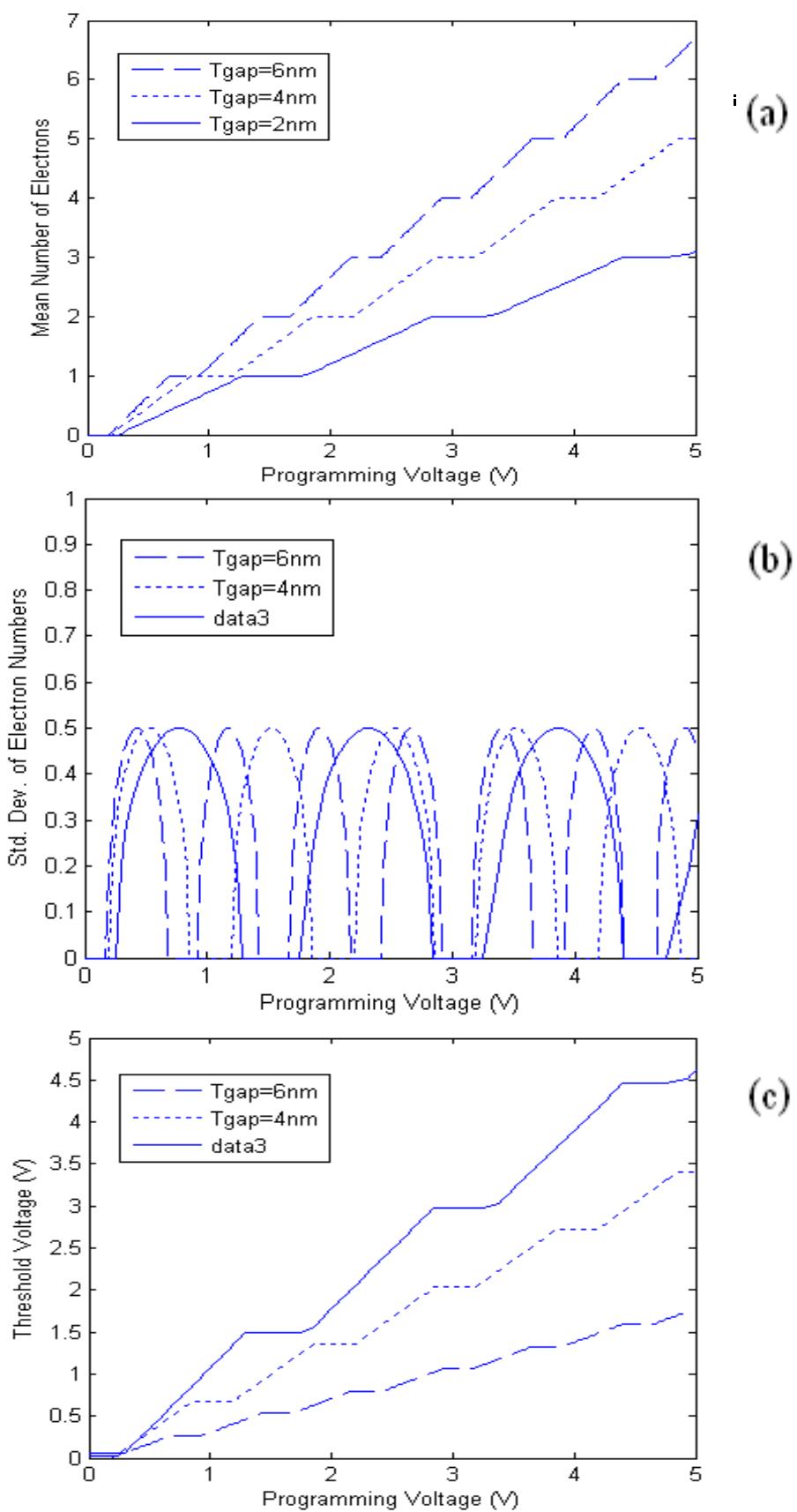
3-1-3 تأثير أوكسيد السيطرة (T_{ctrl}) على خواص البرمجة :

يوضح الشكل (4) تأثير سمك أوكسيد السيطرة على خواص البرمجة :

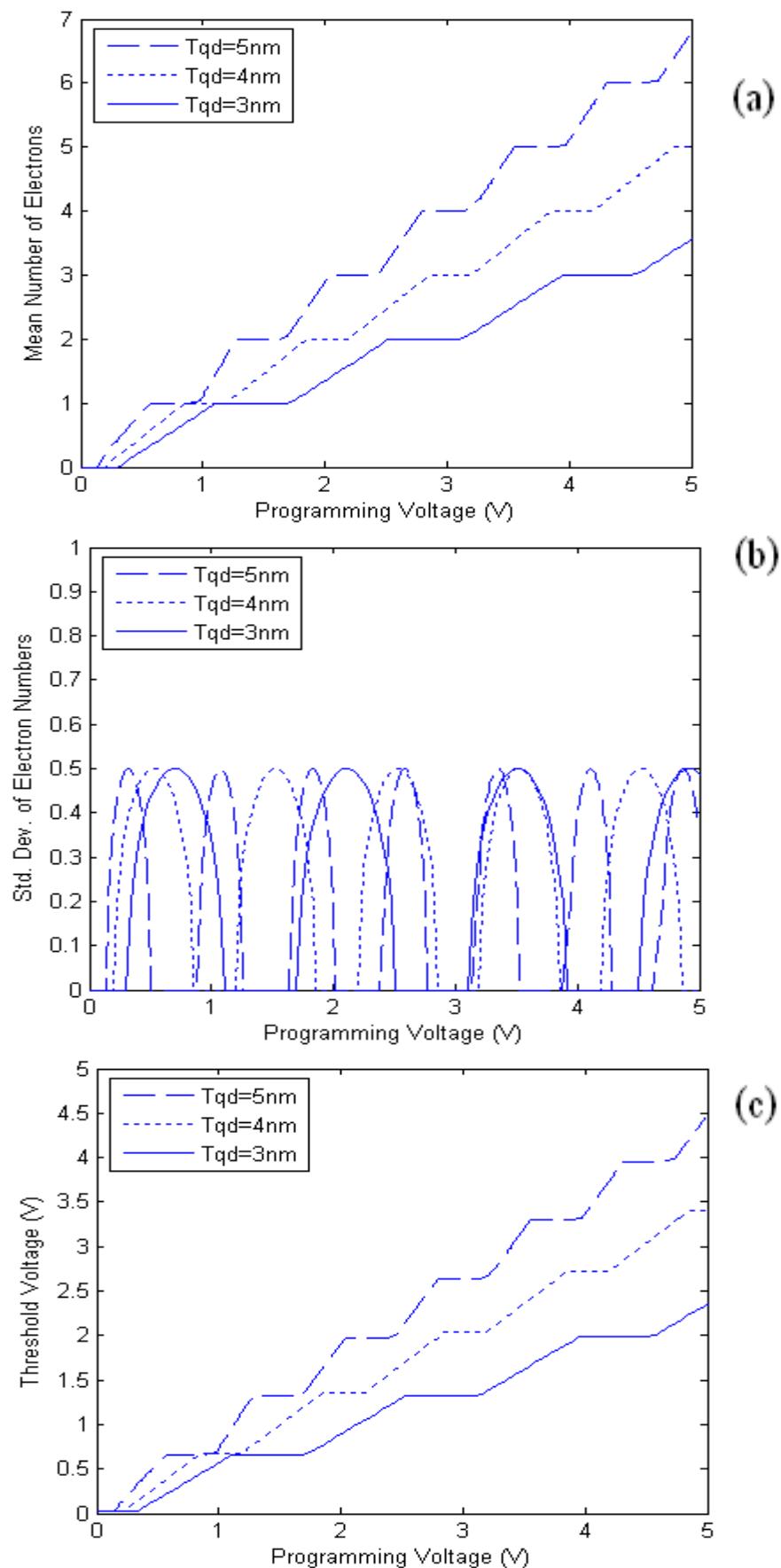
من المعروف أن زيادة (ΔV_{th}) تحتاج لأوكسيد سيطرة سميك، لكنه يلزم ذلك زيادة (ΔV_p) وهي من المساوى وذلك لأن زيادة سمك أوكسيد السيطرة يضعف المجال الكهربائي على القناة عند فولتية إنحياز معينة على البوابة لذلك يقل عدد الإلكترونات التي يمكن خزنها في النقطة. من ناحية أخرى في حالة شحنة ثابتة لنقاط الكم فإن سمك أوكسيد السيطرة الأكبر يحتاج إلى فولتية بوابة أكبر ليحدث نفس الكمية من حاملات الشحنة في القناة والذي يؤدي الى زيادة (ΔV_{th}). الشكل (4-c) يظهر بوضوح أن ($T_{ctrl} = 20nm$ و $\Delta V_p = \Delta V_{th}$) عند ($T_{ctrl} = 10nm$ ، لذلك يتداخل المنحنيان باتجاه زيادة الفولتية).

وبالمقارنة مع الدراسات السابقة فإن تأثير الابعاد الهندسية للذاكرة على خواص البرمجة статистическая لعدد اكبر من نقاط الكم فانها تتشابه فيما عدا ان عدد الإلكترونات المستخدمة اكبر أي سعة خزن اكبر ، ويدل على ان عدد النقاط لا يؤثر كثيراً في الخواص статistica للبرمجة .

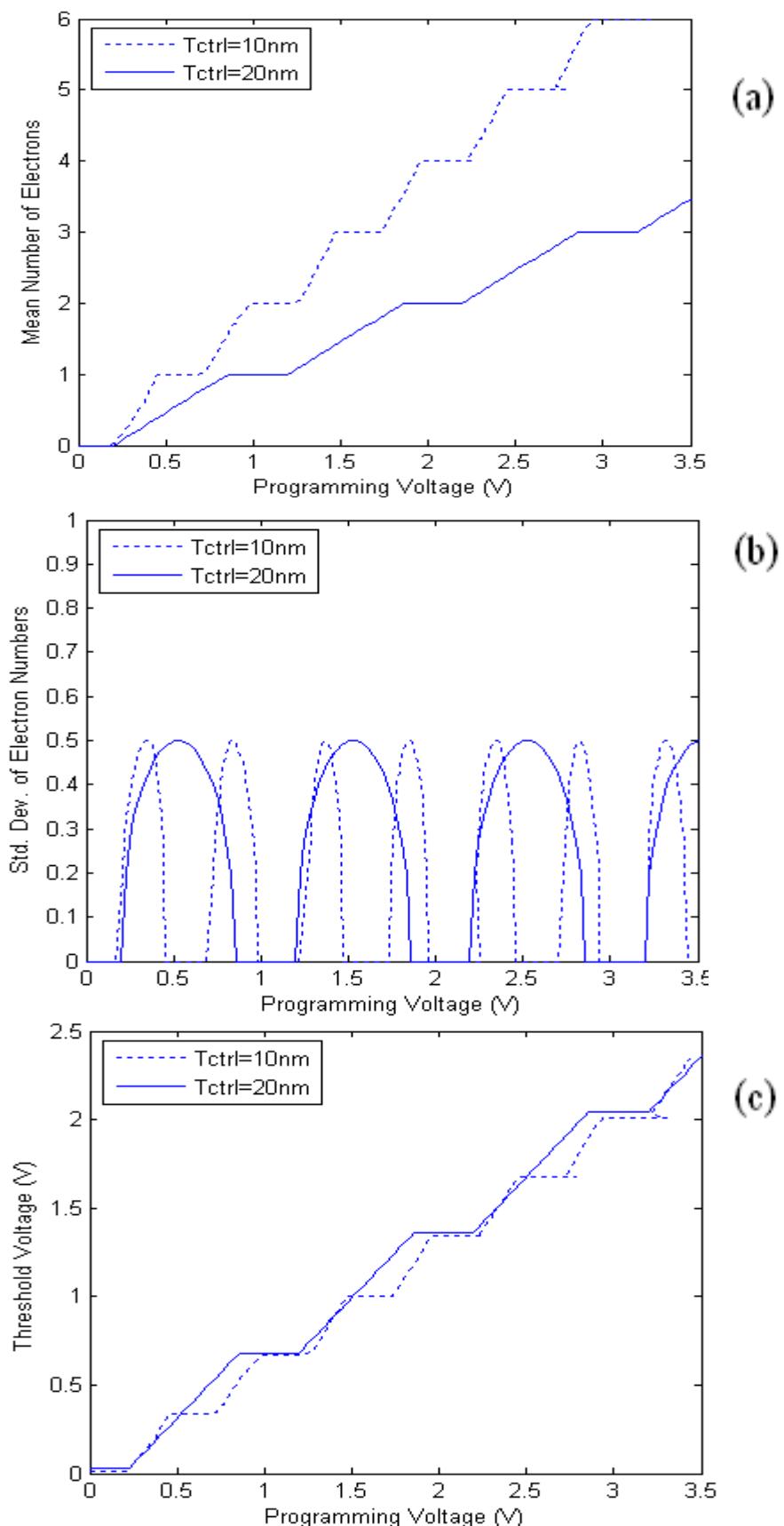
في الشكل (5a) و (5b) يتبيّن أن عدد الإلكترونات يزداد بزيادة المسافة بين نقاط الكم الخزنية وهذا يؤدي إلى زيادة سعة الخزن. أما الشكل (5c) فالملحوظ فيه أن عدد الإلكترونات يقل بزيادة سمك أوكسيد السيطرة والذي يعمل على نقصان سعة الخزن .



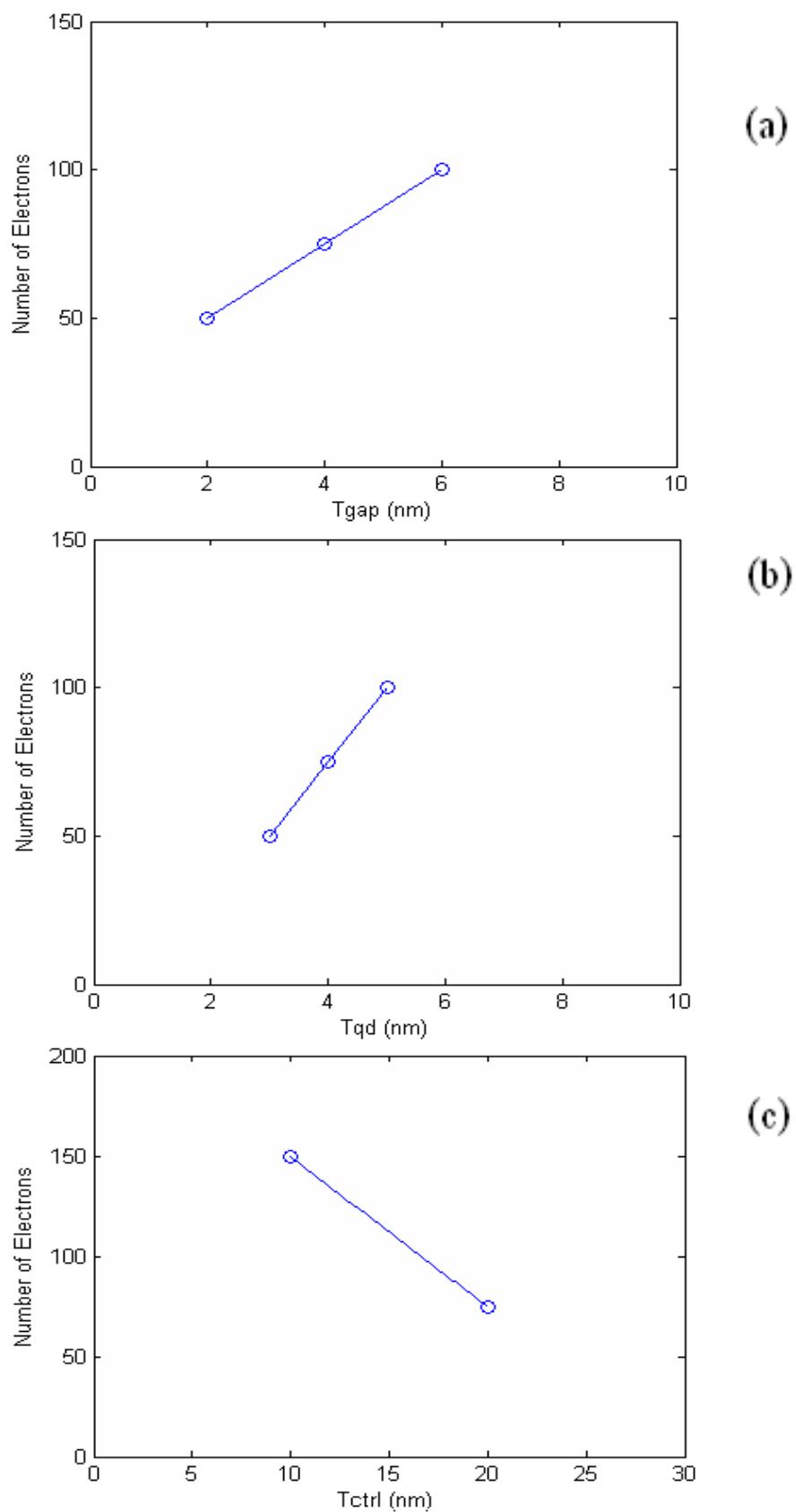
الشكل (2) علاقة المسافة بين النقاط بفولتية البرمجة الستاتيكية للموديل (5×5)



الشكل (3) علاقة حجم النقطة بخواص البرمجة статистическая للمودع (5×5)



الشكل (4) علاقة سماكة أوكسيد السبطرة بخواص البرمجة статистيكية للنموذج (5×5)



الشكل (5) العلاقة بين عدد الالكترونات في نقاط الكم والابعاد الهندسية عند
(5×5) للنموذج ($V_g = 3$ V)

4- الاستنتاجات :

لقد تم بناء تقنية محاكاة ومعالجتها للتبؤ بخواص الذاكرات النانولورية بالاعتماد على معاملات مختلفة للنبيطة وذلك بدمج طريقة (مونتي - كارلو) لمحاكاة شبكات مفارق التفوق-الاحادي مع نموذج مقاومة القناة. من هذه الطريقة يمكن ايجاد العلاقة بين اداء الذاكرات النانولورية ومعاملات النبيطة مثل حجم وعدد النقاط والمسافة بينها وسمك اوكسيد بوابة التتفيق وسمك اوكسيد السيطرة. إن أسلوب المحاكاة المستخدم لدراسة خواص الشحن-الاحادي في الذاكرات النانولورية هي :

تصميم نموذج خلية خزينة للذاكرة النانولورية كمنظومة من نقاط الكم الصغيرة ذات العدد (5×5) ومحاكتها بطريقة مونتي كارلو الاحصائية في دوائر تفقيق الالكترونين- الاحادي لغرض دراسة خواص البرمجة.

فقد تبين من النموذج (5×5) انه عندما تكون المسافات بين النقاط كبيرة تظهر صفة التدرج للشحن-الاحادي ، بينما يقل الزحف بفولتية العتبة بين كل حالات حجز الشحنة كذلك عند حالة شحنة ثابتة يكون عدد الالكترونين المخزونة في النقاط اكبر . وبخلاف ذلك فعندما تكون النقاط متقاربة يزداد الزحف بفولتية العتبة بين حالات حجز الشحنة ، بينما يقل عدد الالكترونينات عند حالة شحنة ثابتة ويتشابه ذلك الذاكرات الومضية التقليدية وهذا ما ينافي اعتقاد السائد بان المسافات القريبة بين النقاط أو الكثافة العالمية للنقاط هي دائماً العنصر الفعال في احداث تأثير الالكتروني-الاحادي .اما من ناحية حجم النقطة فعندما يكون صغيراً تزداد فولتية البرمجة المطلوبة لاضافة الكترون واحد (ΔV_p) ويقل عدد الالكترونينات المنتقلة للنقاط عند حالة شحنة ثابتة فتضعف صفة التدرج ، ولكن التغير بفولتية العتبة في كل حالة يكون بسيطاً . واما تأثير اوكسيد السيطرة فانه لزيادة (ΔV_{th}) تحتاج اوكسيد سيطرة كبير يلزم ذلك زيادة (ΔV_p) . وفي حالة شحنة ثابتة لنقاط الكم فان سمك الاوكسيد الافضل يؤدي الى زيادة (ΔV_{th}) ويلاحظ ان (ΔV_{th}) و (ΔV_p) تساوي ضعف ما هي عليه عند مضاعفة سمك الاوكسيد . وقد تبين من نموذجنا (5×5) أن عدد الالكترونينات في نقاط الكم عند حالة شحنة ثابتة يكون اكبر مما يعني امكانية زيادة عدد بتات الخزن اي زيادة الكثافة الخزنية .

المصادر :

1. Yu Y.S., Choi B.H., Oh J.H., Hwang S.W. & Ahn D., December 2001,"Single Electron Memory with Silicon Self - Asseubled", Journal of the Korean Physical Society, Vol. 39, PP. 527 N S29.
2. Sung S.K., Kim D.H., Sim J.S., kim K.R., Lee Y.K., Lee J.D., Chae S. D., Kim B.M. & Park B.G., April 2002, "Single - Electron MOS Memory with a Defined Quantum Dot Based on Conventional VLSI Technology", The Japan Society of Applied Physics, Vol.41, PP. 2606 – 2610.
3. Brault J., Saitoh M., Kim I., Yanagidaira K. & Hiramoto T.,2002, "Fabrication of nano - scale MOSFETs for the Realization of Single-Electron Memories", Limms/ Cnrs – IIS, University of Tokyo, 4-6-1, Komaba, Megnro, Ku, 153-8505 Tokyo Japan.
4. Sim J.S., Lee J.D. & Park B.G., 2004, "The Simulation of Single-Charging Effects in the Programming Characteristics of Nanocrystal Memories", IOP Publishing Ltd, Seol National University.
5. Sim J.S., Kong J., Lee J.D. & Park B.G., 2004, "Monte-Carlo Simulation of Single-Electron Nanocrystal Memories", Japanese Journal of Applied Physics, Vol.43, No.4B, PP. 2041-2045.
6. Sim J. S., Kong J., Lee J. D. & Park B.G., 2003, "Monte-Carlo Simulation of Single-Electron Nanocrystal Memories", Extended Abstracts of the 2003 International Conference on Solid State Devices & Materials, Tokyo, PP. 850-851.
7. Neamen D. A., 1992, "Semiconductor Physics and Devices", Richard D. Irwin, INC. Australia.